

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月8日(08.05.2025)



(10) 国際公開番号

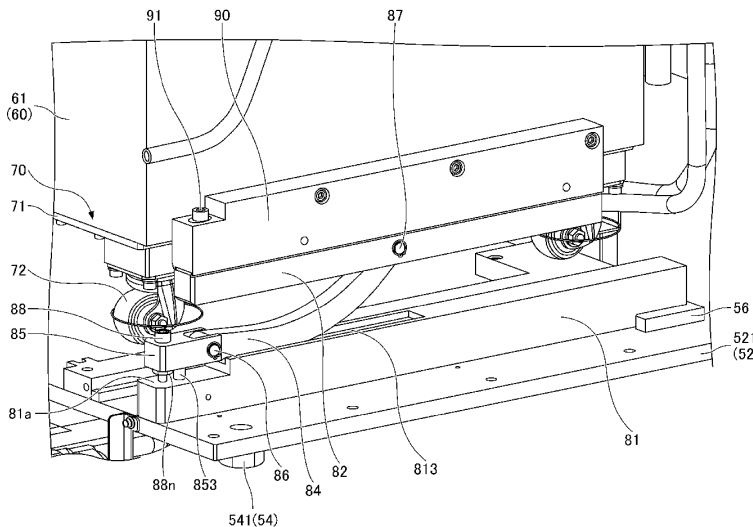
WO 2025/094989 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *H01L 21/683* (2006.01)
H01L 21/31 (2006.01) *H01L 21/3065* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/038678
- (22) 国際出願日: 2024年10月30日(30.10.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-187933 2023年11月1日(01.11.2023) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).
- (72) 発明者: 早坂 友輔 (HAYASAKA, Yusuke); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).
松本 和也(MATSUMOTO, Kazuya); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人 I T O H (ITOH PATENT ATTORNEY CORPORATION); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル16階 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

(54) Title: SEMICONDUCTOR PRODUCTION DEVICE AND INSTALLATION METHOD

(54) 発明の名称: 半導体製造装置、および設置方法

[図5]



(57) Abstract: According to the present invention, a semiconductor production device that produces semiconductors includes: an accommodated object that is provided inside a device frame of the semiconductor production device; and a holding member that is accommodated inside the device frame with the accommodated object and holds the accommodated object. The holding member comprises a base body, an attachment body that is attached to a lower part of the accommodated object, and a floating structure that is provided between the base body and the attachment body and raises

[続葉有]

WO 2025/094989 A1

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

the attachment body from the base body.

(57) 要約: 半導体製造装置は、半導体を製造する半導体製造装置であって、前記半導体製造装置の装置フレームの内部に設置される収容物と、前記収容物と共に前記装置フレームの内部に収容され、当該収容物を保持する保持部材と、を含む。前記保持部材は、ベース体と、前記収容物の下部に取り付けられる取付体と、前記ベース体と前記取付体の間に設けられ前記ベース体から前記取付体を上昇させる浮上構造と、を備える。